

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

(affiliée à l'Organisation Internationale de Normalisation — ISO)

RECOMMANDATION DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

(affiliated to the International Organization for Standardization — ISO)

IEC RECOMMENDATION

Modification N° 1

Septembre 1969

à la Publication 171

(Première édition - 1964)

Amendment No. 1

September 1969

to Publication 171

(First edition - 1964)

Paramètres fondamentaux des connecteurs pour plaquettes de câblage imprimé

Fundamental parameters of connectors for printed wiring boards

Les modifications contenues dans le présent document ont été approuvées suivant la Règle des Six Mois.

Les projets de modifications furent discutés par le Sous-Comité 48B et, après avoir été approuvés par le Comité d'Etudes N° 48, furent diffusés en novembre 1967 pour approbation suivant la Règle des Six Mois, puis suivant la Procédure des Deux Mois en novembre 1968.

The amendments contained in this document have been approved under the Six Months' Rule.

The draft amendments were discussed by Sub-Committee 48B and, after approval by Technical Committee No. 48, were circulated for approval under the Six Months' Rule in November 1967, then under the Two Months' Procedure in November 1968.



Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

1, rue de Varembe

Genève, Suisse

MODIFICATIONS A LA PUBLICATION 171 DE LA CEI :

PARAMÈTRES FONDAMENTAUX DES CONNECTEURS
POUR PLAQUETTES DE CÂBLAGE IMPRIMÉ

(Première édition - 1964)

Page 6

Article 3. Epaisseur des plaquettes

Le texte actuel est remplacé par le suivant :

Les connecteurs doivent être construits de telle façon qu'ils puissent s'accoupler avec une plaquette dont l'épaisseur est comprise dans l'une des limites spécifiées au tableau I.

TABLEAU I

Epaisseur nominale		Limites de l'épaisseur			
		Min.		Max.	
mm	in	mm	in	mm	in
0,8	0,031	0,67	0,026	0,93	0,037
1,6	0,063	1,42	0,055	1,78	0,070
2,4	0,094	2,18	0,085	2,62	0,103
3,2	0,125	2,96	0,116	3,44	0,135

Note. — Dans les dimensions ci-dessus sont comprises les épaisseurs de la feuille métallique ainsi que celles des revêtements électrolytiques éventuels des bandes conductrices, simple ou double face. Dans le cas de connecteurs pouvant être accouplés à des cartes imprimées comportant des contacts renforcés, les limites supérieures et inférieures devront être spécifiées par la spécification de détail du connecteur.

AMENDMENTS TO IEC PUBLICATION 171 :
FUNDAMENTAL PARAMETERS OF CONNECTORS
FOR PRINTED WIRING BOARDS
(First edition - 1964)

Page 7

Clause 3. Board thicknesses

The present text is replaced by the following :

The connectors shall be so designed that they can mate with a board having a thickness falling within one of the ranges specified in Table I.

TABLE I

Nominal thickness		Limits of thickness			
		Min.		Max.	
mm	in	mm	in	mm	in
0.8	0.031	0.67	0.026	0.93	0.037
1.6	0.063	1.42	0.055	1.78	0.070
2.4	0.094	2.18	0.085	2.62	0.103
3.2	0.125	2.96	0.116	3.44	0.135

Note. — In the above dimensions, thicknesses of metal foil together with possible contact platings, either single or double sided, are included. In case of connectors suitable for mating with boards bearing reinforced contacts, the upper and lower limits shall be stated in the detailed connector specification.
